

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
 定時株主総会 毎年6月
 基準日 毎年3月31日
 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063
 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
 電話照会先 **フリーダイヤル** 0120-782-031
 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の
 本店および全国各支店で行っております。

ホームページの
ご案内

IR情報につきましては当社ホームページにも
記載されておりますので、ご覧ください。



<http://www.seikoh-giken.co.jp/>



株主通信

2019年3月期(第47期) 事業報告
 2018年4月1日~2019年3月31日

特集

1. 中期経営計画『マスタープラン2016』の目標達成に向けて
2. キーマンインタビュー
自動車の電装化とスマートフォンの
進化を支える~不二電子工業~

『マスタープラン2016』の第2フェーズも、

企業価値の持続的な成長に取り組みます。

2019年3月期の業績について

創業以来の過去最高売上高を更新し、前期と比べ大幅増収増益となりました。

当連結会計年度の情報通信関連やエレクトロニクス関連市場においては、スマートフォンの世界需要が減少する一方、AIやIoTを活用したビジネスや業務の変革が進みました。インターネットを介して流通するデジタルデータ量も急増しており、重要なデータを保管するデータセンターの建設が世界各国で進んだほか、第5世代無線通信規格「5G」の導入をひかえ、基地局等に用いられる高機能な光通信デバイスの開発に拍車がかかることとなりました。

こうした中で当社グループは、2016年度からスタートさせた6ヶ年にわたる中期経営計画『マスタープラン2016』の3年度目として、引き続き「既存事業の収益力強化」、「事業ポートフォリオの最適化」、「経営基盤の強化」の各施策の遂行に取り組みました。

その結果、当連結会計年度の売上高は155億2百万円となり、当社創業以来の最高売上高を更新することができました。営業利益は16億19百万円、経常利益も17億54百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は12億32百万円となり、前期から大幅な増収増益となりました。

配当について

3円増配し、1株当たり30円を予定

期末配当につきましては、株主の皆様に対して安定的な剰余金配当を行うという方針を基に当事業年度の業績、内部留保等のバランスを鑑み、前事業年度実績から1株当たり3円を増額し、1株当たり30円とさせていただきます。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長
上野 昌利



セグメント別の業績について

● 精機事業

スマートフォンやモバイル端末のキーボードに使用されるプレス成形品の販売が伸びました。また、自動車の燃料噴射圧やブレーキ圧を感知するセンサー用基幹部品や、燃料供給を電子制御するエンジンコントロールユニット用ケース等のインサート成形品も堅調に売上を伸ばすことができました。車載用成形品の増産を目的に一昨年に新設した北海道千歳市の工場は、静岡県の既存工場からの生産移管が順調に進んでおり、当連結会計年度末現在で約9割の製造ライン導入を終えています。

開発面では、創業以来培ってきた精密金型技術や薄肉成形技術、ミクロン単位の凹凸を正確に写し取る微細転写技術を応用し、自動車や医療、バイオ等の産業領域において、お客様と共に新たな製品の量産化に向けた技術課題の解消に取り組みしました。

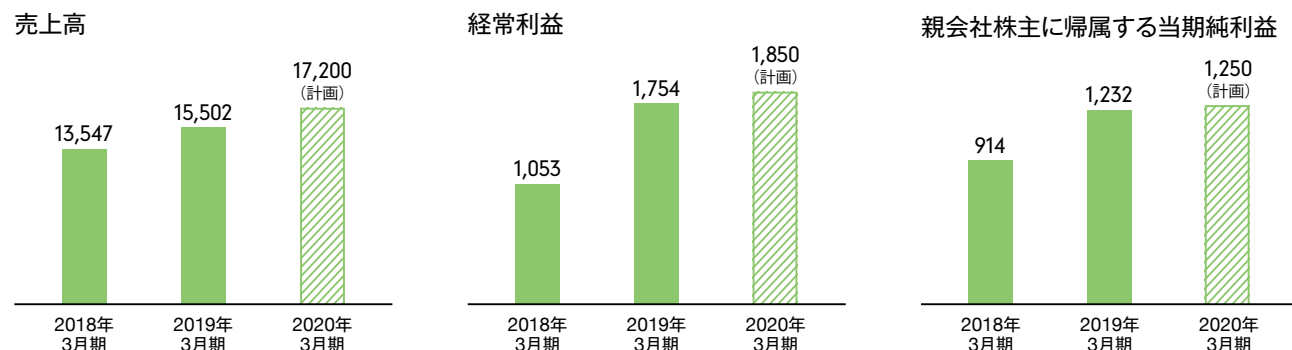
これらの結果、当連結会計年度の売上高は87億29百万円、営業利益は7億53百万円となりました。

● 光製品事業

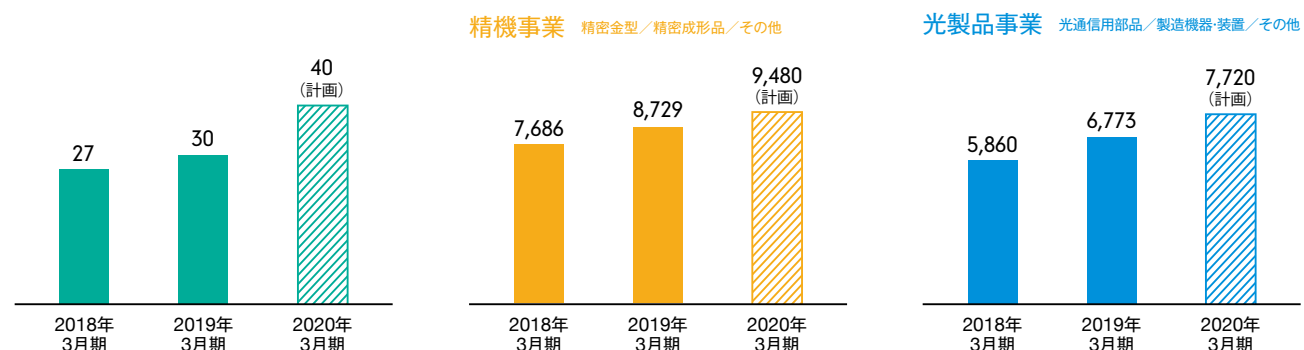
インターネットを介して流通するデジタルデータ量が増加していることを受けて、光通信インフラの拡充やビッグデータを処理・保管するデータセンターの建設が世界の各地で積極的に進められています。当連結会計年度は、中国の電子商取引大手企業が新設するデータセンターに当社グループの光コネクタが採用されることとなり、光通信用品の売上が大幅に増加しました。また、世界各国で第5世代の無線通信規格「5G」の実用化に向けた準備が進んでいることを受けて、需要が増加している光通信用品を製造するための機器や装置も売上を伸ばしました。開発面では、現行のハイビジョンを超える高画質な映像規格「4K」や「8K」に対応し、高精細なテレビ映像を安定的に中継するための光伝送装置や、特殊な耐熱樹脂を用いた超小型レンズの量産方法の確立等に取り組みしました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は67億73百万円、営業利益は8億65百万円となりました。

◆ 連結損益計算書の概要 (単位:百万円)



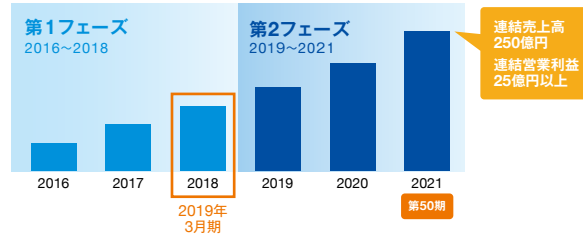
◆ 一株当たり配当金 (単位:円) ◆ セグメント別概況 売上高の推移 (単位:百万円)



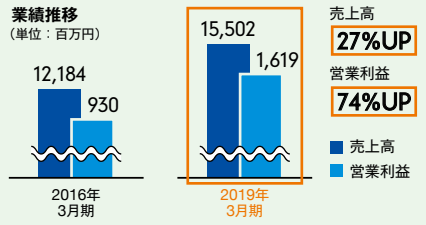
中期経営計画『マスタープラン2016』の 目標達成に向けて

当社グループは2016年度から、中期経営計画『マスタープラン2016』を推進しています。当期で前半3年間の「第1フェーズ」が終了し、2019年度から後半の「第2フェーズ」が始まっています。基本方針として定めた3つの施策ごとに、第1フェーズの総括と第2フェーズの取り組みをまとめました。

第50期となる2021年度を最終年度とする6ヶ年中期計画
マスタープラン2016



連結売上高
250億円
連結営業利益
25億円以上



■ 既存事業の収益力の強化

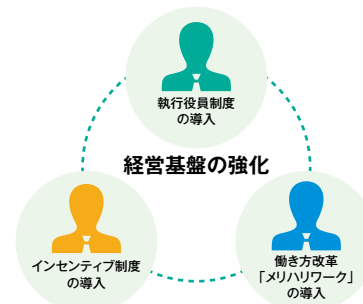
精機事業は車載用センサー部品の売上が拡大し、北海道千歳市に新設した工場への生産移管を進めました。光製品事業は、中国のデータセンター向けに光コネクタの売上が拡大しました。この結果、第1フェーズの3年間で売上高は約33億円増加（27%増）、営業利益は約7億円増加（74%増）させることができました。第2フェーズも引き続き、精機、光製品の両事業において、販売力の強化と価格競争力の強化、新製品と新技術の開発に取り組みます。

■ 事業ポートフォリオの最適化

2017年4月にDATA PIXEL社を連結子会社化したほか、2018年7月には中国の投資会社と合弁会社、浙江精工光电科技有限公司を立ち上げ、光製品事業の製品ラインアップと販路の拡大を図りました。また、「成長期待事業」に位置付けていた光通信部品は売上が拡大し、「成長牽引事業」へとポジションを移行させることができました。第2フェーズは、「成長期待事業」にある「レンズ」や「精密成形品」の収益貢献を実現させるほか、キャッシュを有効に活用して「次世代事業」を創出する計画です。

■ 経営基盤の強化

2016年には、取締役会の機能を強化するため監査等委員会設置会社に移行したほか、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化を図りました。また、役員や従業員に対して、会社の業績に応じたインセンティブ制度を導入し、企業価値の向上と、役員・従業員のモチベーションを連動させる仕組みを作りました。そのほか、精工技研本社では働き方改革「メリハリワーク」を導入し、「より短い時間でより多くの売上を上げる」活動を通して生産性の向上に取り組みました。第2フェーズも引き続き経営基盤を強化し、拡大する業績と組織を安定的に支える体制を構築してまいります。



キーマンインタビュー 自動車の電装化とスマートフォンの進化を支える～不二電子工業～



不二電子工業株式会社 代表取締役社長 兼
株式会社精工技研 専務取締役

木村 保氏

不二電子工業は、当社グループの連結売上高の約50%を占める中核会社。静岡県に2工場、北海道に1工場の3拠点体制で、センサー等の自動車用部品と、スマートフォンやキーボード向けの金属スイッチ部品等を生産しています。当期の売上高は前期比17%増の78億円となり、過去最高を記録。好調の要因と今後の戦略を、同社代表取締役社長 兼 精工技研専務取締役 木村 保氏に伺いました。

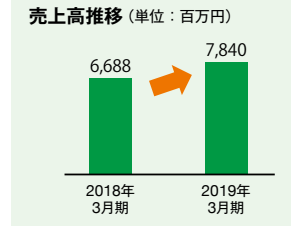


不二電子工業 本社工場

Q 業績が好調な要因について教えてください。

当社の技術、お客様との強い信頼関係が現在の業績につながっております。

自動車産業は今、「CASE」(Connected:コネクティッド化)(Autonomous:自動運転化)(Shared/Service:シェア/サービス化)(Electric:電動化)と呼ばれる大きな変化点を迎えており、自動車内部に搭載する電装部品が増加しています。当社は、樹脂と金属を一体成形する「インサート成形」の高い技術を有しており、増加する電装部品のニーズに対して高品質なセンサー部品等を供給しています。親会社の精工技研から高精度な金型を入手できるのも強みのひとつです。



また、薄型ノートパソコン向けのキーボードや、スマートフォンのサイドスイッチ等に用いられる小さく薄い金属製のバネ部品は、押下する感触や耐久性を実現するための技術的要素が高い製品です。当社は1963年の創業以来、お客様のご要望に応える形で精密プレス成形技術に磨きをかけ、これを実現してきました。現在ではハイスpek的なモバイル端末向けのスイッチ部品は、世界でも当社を含めて数社しか作ることができません。

市場の変化に加えて、優位性のある当社の技術、お客様との強い信頼関係が現在の業績につながっていると考えています。

Q 今後の戦略について教えてください。

車載用センサー部品に関しては量産化と新規お客様の開拓、プレス成形部品に関しては生産効率の向上に努めてまいります。

車載用のセンサー部品に関しては、一昨年新設した北海道千歳市の工場に生産を移管しているところです。移管は順調に進んでおり、2020年3月末には計画どおり、23の製造ラインが埋まる見通しです。一方、静岡県の既存工場では、お客様から新しい製品のご発注をいただき、量産化に取り組んでいます。また、展示会への出展を増やすほかホームページのリニューアル等を行い、新規のお客様との接点を増やしていく考えです。

モバイル端末向けのプレス成形部品に関しては、スマートフォン市場の先行きが不安定な状況にあります。このため、既存のお客様との関係強化を図りながらも、モバイル端末以外の用途に向けた販路開拓にも取り組みます。並行して、金型の改善等による生産効率の向上に努めてまいります。

これからも精工技研グループの中核企業として力強く牽引していきたいと考えています。今後ともご支援くださいますようお願い申し上げます。



不二電子工業 千歳工場



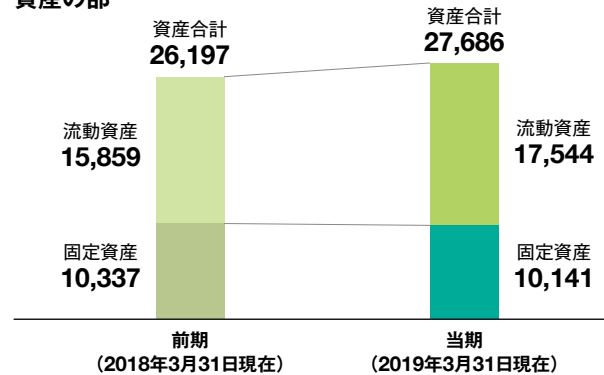
ケースプラグ ドームコンタクト

連結財務諸表(要約)

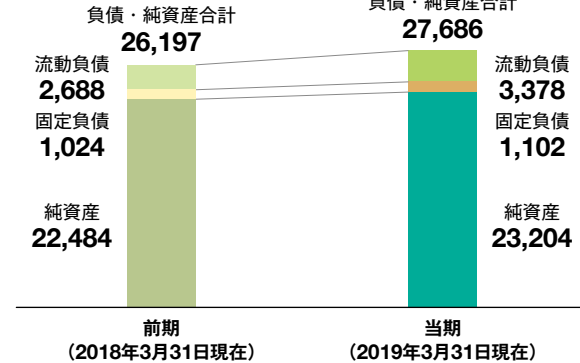
単位：百万円、単位未満切り捨て

■ 連結貸借対照表

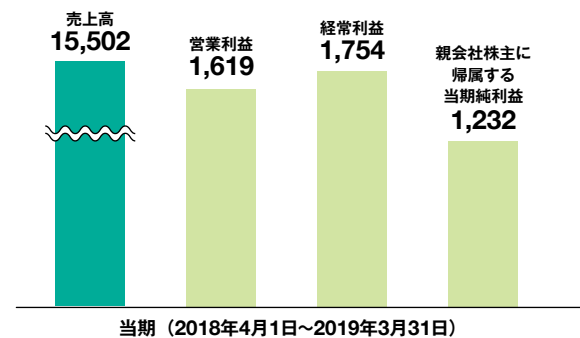
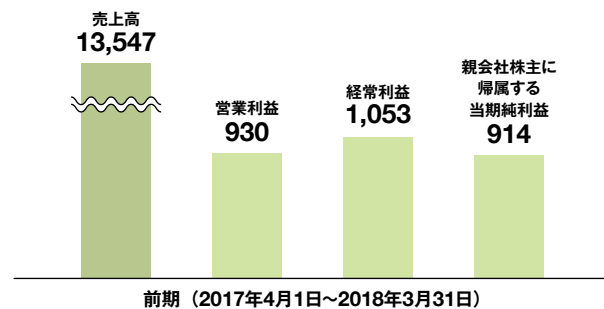
資産の部



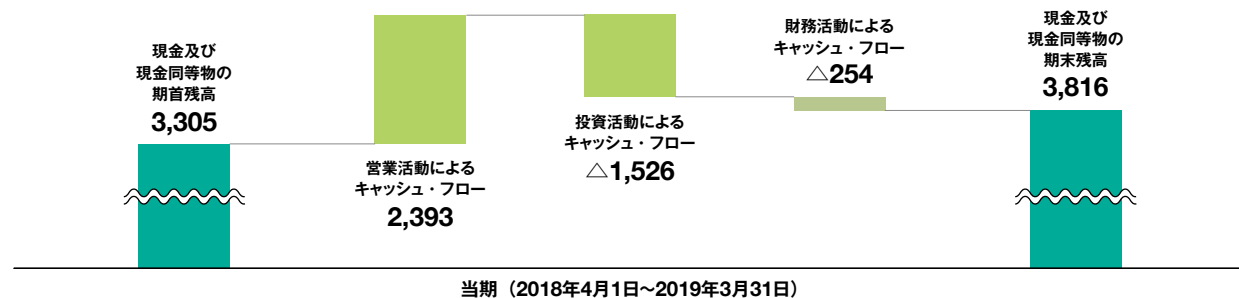
負債・純資産の部



■ 連結損益計算書



■ 連結キャッシュ・フロー計算書



会社情報 / 株式情報

■ 会社概要 (2019年3月31日現在)

会社名 株式会社 精工技研
 本社 千葉県松戸市松飛台296番地の1
 創業 1972年6月
 資本金 6,791,682,700円
 従業員数 898人
 事業所 本社工場、第2工場、第4工場、台湾支店
 グループ会社

子会社

SEIKOH GIKEN USA, INC.
 杭州精工技研有限公司
 SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH
 大連精工技研有限公司
 不二電子工業株式会社
 DATA-PIXEL SAS

関係会社

浙江精工光电科技有限公司

■ 役員 (2019年6月21日現在)

代表取締役社長	上野 昌利
専務取締役	木村 保
常務取締役	來 関明
常務取締役	上野 淳
取締役 (社外取締役)	大久保 勝彦
取締役 (社外取締役)	谷田貝 豊彦
取締役 (監査等委員)	森 保彦
取締役 (監査等委員、社外取締役)	三好 徹
取締役 (監査等委員、社外取締役)	相場 俊夫

■ 株式の状況 (2019年3月31日現在)

発行可能株式総数	37,000,000株
発行済株式の総数	9,333,654株
株主数	2,468名

■ 大株主の状況 (2019年3月31日現在)

株主名	持株数 (株)	発行済株式(自己株式を除く.)の総数に対する所有株式数の割合 (%)
上野 昌利	890,000	9.57
有限会社高志	725,500	7.80
有限会社光研	654,500	7.04
木村 保	609,200	6.55
細江由紀子	432,500	4.65
都丸由美子	430,500	4.63
上野 淳	334,900	3.60
吉田 智恵	334,000	3.59
高橋 藤子	321,600	3.46
細江 一稀	249,000	2.68

所有者別株式分布状況

